



2025年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2024年7月11日

上場会社名 ローツェ株式会社 上場取引所 東
コード番号 6323 URL <https://www.rorze.com>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 藤代 祥之
問合せ先責任者 (役職名) 管理部長 (氏名) 伊勢村 英一 (TEL) 084-960-0001
四半期報告書提出予定日 2024年7月16日 配当支払開始予定日 -
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2025年2月期第1四半期の連結業績（2024年3月1日～2024年5月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年2月期第1四半期	29,288	75.5	8,748	85.4	11,361	118.1	8,774	146.7
2024年2月期第1四半期	16,693	△23.0	4,718	△6.2	5,208	△27.5	3,557	△30.6

(注) 包括利益 2025年2月期第1四半期 11,830百万円 (205.9%) 2024年2月期第1四半期 3,867百万円 (△46.1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年2月期第1四半期	498 18	497 26
2024年2月期第1四半期	201 91	201 54

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2025年2月期第1四半期	161,752	108,515	62.4
2024年2月期	156,136	99,550	59.1

(参考) 自己資本 2025年2月期第1四半期 100,949百万円 2024年2月期 92,213百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年2月期	-	0 00	-	135 00	135 00
2025年2月期	-	-	-	-	-
2025年2月期（予想）	-	0 00	-	16 00	16 00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

(注) 当社は、2024年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施する予定です。そのため2025年2月期（予想）は当該株式分割の影響を考慮した金額を記載しております。

3. 2025年2月期の連結業績予想（2024年3月1日～2025年2月28日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期（累計）	61,474	50.0	17,298	73.8	17,300	24.7	12,604	28.2	715.39
通期	120,784	29.5	31,617	31.0	31,518	16.4	22,916	17.1	130.07

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

(注) 当社は、2024年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施する予定です。そのため2025年2月期の通期連結業績予想における1株当たり当期純利益は当該株式分割の影響を考慮しております。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動：無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 一社 (社名) 、除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2025年2月期1Q	17,640,000株	2024年2月期	17,640,000株
② 期末自己株式数	2025年2月期1Q	34,691株	2024年2月期	19,791株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2025年2月期1Q	17,612,597株	2024年2月期1Q	17,616,538株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述について)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7
(重要な後発事象)	8
3. 補足情報	9
生産、受注及び販売の状況	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や設備投資に持ち直しの動きが見られ、景気は緩やかに回復しました。しかし、世界的な金融引締めの影響による景気減速リスクや地政学リスクの高まりなど、依然として不確実性が残る状況が続いております。

当業界におきましては、半導体需要の回復と在庫の正常化が進み、特にHBM（High Bandwidth Memory：高帯域幅メモリ）を中心とするAI関連の半導体需要が回復を主導しました。さらに、自国のサプライチェーン強化を目的に、中国において半導体製造拠点の増強が活発化し、それに伴う半導体製造装置への投資が顕著に増加しました。

このような状況の中、当社グループの当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高29,288百万円（前年同期比75.5%増）、営業利益8,748百万円（前年同期比85.4%増）、経常利益11,361百万円（前年同期比118.1%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益8,774百万円（前年同期比146.7%増）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

半導体・FPD関連装置事業の売上高は29,135百万円（前年同期比75.6%増）、セグメント利益は8,962百万円（前年同期比83.0%増）となりました。

ライフサイエンス事業の売上高は152百万円（前年同期比52.1%増）、セグメント損失は40百万円（前年同期はセグメント損失62百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ5,615百万円増加し、161,752百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加2,255百万円及び受取手形及び売掛金の増加1,412百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ3,348百万円減少し、53,237百万円となりました。これは主に、借入金の減少2,294百万円によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ8,964百万円増加し、108,515百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加6,395百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2025年2月期の第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、2024年4月11日発表の「2024年2月期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載しております予想数値から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年2月29日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	37,951	40,206
受取手形及び売掛金	26,457	27,870
商品及び製品	6,866	5,820
仕掛品	12,545	13,204
原材料及び貯蔵品	33,873	34,372
その他	2,457	2,133
貸倒引当金	△10	△18
流動資産合計	120,140	123,589
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	11,037	11,726
機械装置及び運搬具（純額）	5,657	5,751
土地	4,769	4,876
その他（純額）	1,155	936
有形固定資産合計	22,621	23,291
無形固定資産		
のれん	2,319	2,255
その他	2,901	2,889
無形固定資産合計	5,221	5,144
投資その他の資産		
投資有価証券	3,192	3,547
退職給付に係る資産	244	252
繰延税金資産	1,959	1,933
その他	2,815	4,055
貸倒引当金	△58	△61
投資その他の資産合計	8,153	9,727
固定資産合計	35,996	38,163
資産合計	156,136	161,752

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年2月29日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年5月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	6,392	6,152
短期借入金	16,336	15,363
未払法人税等	4,567	3,352
賞与引当金	1,359	1,385
役員賞与引当金	4	1
製品保証引当金	1,422	1,406
その他	6,347	7,002
流動負債合計	36,430	34,664
固定負債		
長期借入金	18,167	16,846
役員退職慰労引当金	423	429
退職給付に係る負債	82	85
資産除去債務	302	326
繰延税金負債	997	704
その他	182	180
固定負債合計	20,156	18,573
負債合計	56,586	53,237
純資産の部		
株主資本		
資本金	982	982
資本剰余金	5,231	5,231
利益剰余金	78,465	84,861
自己株式	△3	△441
株主資本合計	84,677	90,634
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	292	361
為替換算調整勘定	7,243	9,953
その他の包括利益累計額合計	7,535	10,314
新株予約権	85	85
非支配株主持分	7,251	7,480
純資産合計	99,550	108,515
負債純資産合計	156,136	161,752

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)
売上高	16,693	29,288
売上原価	9,749	17,659
売上総利益	6,943	11,629
販売費及び一般管理費	2,225	2,881
営業利益	4,718	8,748
営業外収益		
受取利息	2	51
為替差益	526	2,731
売電収入	15	15
その他	81	59
営業外収益合計	626	2,858
営業外費用		
支払利息	18	16
売電費用	4	4
デリバティブ損失	101	210
その他	11	12
営業外費用合計	136	245
経常利益	5,208	11,361
特別利益		
固定資産売却益	2	0
特別利益合計	2	0
特別損失		
固定資産売却損	0	-
固定資産除却損	0	0
特別損失合計	0	0
税金等調整前四半期純利益	5,210	11,362
法人税、住民税及び事業税	1,470	2,732
法人税等調整額	37	△270
法人税等合計	1,507	2,462
四半期純利益	3,702	8,899
非支配株主に帰属する四半期純利益	145	125
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,557	8,774

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)
四半期純利益	3,702	8,899
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	15	69
為替換算調整勘定	148	2,861
その他の包括利益合計	164	2,931
四半期包括利益	3,867	11,830
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,861	11,553
非支配株主に係る四半期包括利益	5	277

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2024年4月11日開催の取締役会決議に基づき、自己株式14,900株の取得を行いました。この結果、当第1四半期連結累計期間において自己株式が438百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末において自己株式が441百万円となっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期 連結財務諸表 計上額 (注) 2
	半導体・FPD 関連装置事業	ライフ サイエンス 事業	計		
売上高					
日本	2,996	47	3,044	—	3,044
台湾	3,762	—	3,762	—	3,762
中国	13,360	3	13,364	—	13,364
韓国	947	—	947	—	947
米国	7,171	101	7,272	—	7,272
その他	897	—	897	—	897
顧客との契約から生じる収益	29,135	152	29,288	—	29,288
外部顧客への売上高	29,135	152	29,288	—	29,288
セグメント間の内部売上高又は振替高	104	—	104	△104	—
計	29,240	152	29,393	△104	29,288
セグメント利益又は損失(△)	8,962	△40	8,921	△173	8,748

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△173百万円であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(重要な後発事象)

(第三者割当増資引受による連結子会社化)

当社は、2024年6月24日開催の取締役会において、Nanoverse Technologies, Ltd. が実施する第三者割当増資の引受により、当社の連結子会社とすることについて決議いたしました。

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 : Nanoverse Technologies, Ltd.

事業の内容 : 半導体製造装置の開発・製造・販売

(2) 企業結合を行った主な理由

Nanoverse Technologies, Ltd. (以下、Nanoverse) は米国オレゴン州を拠点とする半導体製造装置の開発、製造、販売を主な事業としております。Nanoverseは2022年の設立以降、今後の半導体製造プロセスにおいて有用となる技術の研究開発を続け、複数の競争力のある特許を保持しております。Nanoverseは、これら特許技術を組合せ、今後成長が期待されるアドバンスドパッケージ分野において新たな半導体製造装置の開発を行い、評価機を半導体メーカーへ納入する予定であります。また開発中の装置には当社製の搬送装置が採用されており、当社の顧客でもあります。

このような環境下において、Nanoverseは今後の研究開発及び運転資金等にかかる資金需要に対応するため、第三者割当を実施することといたしました。当社は、Nanoverseと当社のコア技術、サービスネットワーク及び生産力などの経営資源を有効活用することにより、両社の半導体関連装置事業の更なる成長を実現することを目的に、第三者割当増資を引き受けることを決定いたしました。

なお、当社が保有する株式に基づく議決権割合は50.00%以下であります。Nanoverseとの資本、人的及び取引関係を勘案し、実質的支配が及び得ると判断したため、連結子会社とすることといたしました。

(3) 企業結合日

2024年7月中(予定)

(4) 企業結合の法的形式

第三者割当増資引受による株式取得

(5) 結合後企業の名称

変更ありません。

(6) 取得予定議決権比率

取得前の議決権所有割合 : - %

取得後の議決権所有割合 : 33.00 %

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得することによるものです。

2. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	70百万USD
取得原価		70百万USD

3. 主要な取得関連費用の内容及び金額

現時点では確定しておりません。

4. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

3. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第1四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	品目	生産高 (百万円)	前年同期比 (%)
半導体・FPD関連装置事業			
	半導体関連装置	15,155	166.7
	FPD関連装置	293	112.5
	計	15,449	164.7
ライフサイエンス事業		215	474.5
	合計	15,664	166.2

(注) 1. 金額は、製造原価によっております。

(2) 受注実績

当第1四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	品目	受注高 (百万円)	前年同期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同期比 (%)
半導体・FPD関連装置事業					
	半導体関連装置	22,616	166.2	52,180	94.0
	分析装置	906	110.5	4,329	90.3
	FPD関連装置	1,145	108.2	4,573	322.4
	計	24,669	159.3	61,083	99.0
ライフサイエンス事業		273	72.5	291	48.5
	合計	24,943	157.2	61,374	98.5

(注) 1. 金額は、販売価格によっております。

(3) 販売実績

当第1四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 品目	販売高 (百万円)	前年同期比 (%)
半導体関連装置	26,836	191.9
分析装置	331	46.3
FPD関連装置	262	75.7
部品・修理 他	1,705	110.5
計	29,135	175.6
ライフサイエンス事業	152	152.1
合計	29,288	175.5

(注) 1. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前第1四半期連結累計期間		当第1四半期連結累計期間	
	販売高 (百万円)	割合 (%)	販売高 (百万円)	割合 (%)
Applied Materials, Inc.	3,934	23.6	5,955	20.3

2. 当第1四半期連結会計期間より、従来「半導体・FPD関連装置事業」に記載していた「モータ制御機器」について、金額的重要性が乏しいため、「部品・修理 他」に含めて記載する方法に変更しております。